



반도체용 웨트 에칭제 계면활성제 첨가 버퍼드 불산 BHF-U 시리즈

웨트 에칭제 계면 활성제 첨가 버퍼드 불산 BHF-U 시리즈는 플루오르화 수소산과 플루오르화 암모늄의 혼합품에 독자적인 계면활성제를 첨가한 타입입니다. 반도체 제조 대상으로 금속 이온 등의 불순물을 대폭적으로 저감한 고품질과 함께 침투성 향상과 웨이퍼로의 입자 부착을 저감한 에칭제입니다.

1. 일반 물성

항목	단위	수치
HF 농도	mass %	혼합 비율에 따름
NH ₄ F 농도	mass %	

【검사항목】

염화물, 질산염, 인산염, 음이온계 물질, 양이온계 물질, 미립자
* 각각의 품질에 관해서는 문의해 주십시오.

2. 취급방법/안전정보

사용 전에 반드시 SDS 를 읽어주십시오.

해당 법규에 따라 포장, 표시, 수송을 하십시오.

3. 포장 사양

5kg, 20kg, 100kg, 1000kg

【연락처】 다이킨코리아주식회사

우편번호: 135-907 서울특별시 강남구 논현로 105 길 48, 나실빌딩 3층